

LPWWG36A

产品特性 Product Features :

芯片尺寸 Dimensions : 36mil x 36mil
(880±50um x 880±50um)

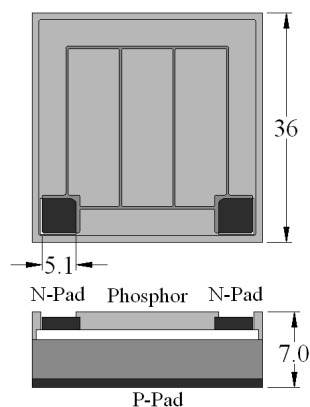
芯片厚度 Chip Thickness : 7mil(175±20um)

焊盘尺寸 Pad Size : 5.1mil(130±10um)

焊盘金属 Pad Material :

N 焊盘 (N PAD) : Au

P 焊盘 (P PAD) : Au



单位: mil

光电性能 (Electronic Parameters) , TA=25°C

参数 Parameters	符号 Symbol	条件 Condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
开启电压 Turn-On Voltage	Vf1	If=10μA	1.9	---	2.8	V
工作电压 Forward Voltage	Vf2	If=350mA	2.8	2.9	3.4	V
反向漏电流 Reverse Leakage Current	IR	Vr=5V	---	---	1	μA
光通量 Luminous Flux	Φ	If=350mA	80	100	120	lm